



DWG. NO. SD-53524-1364

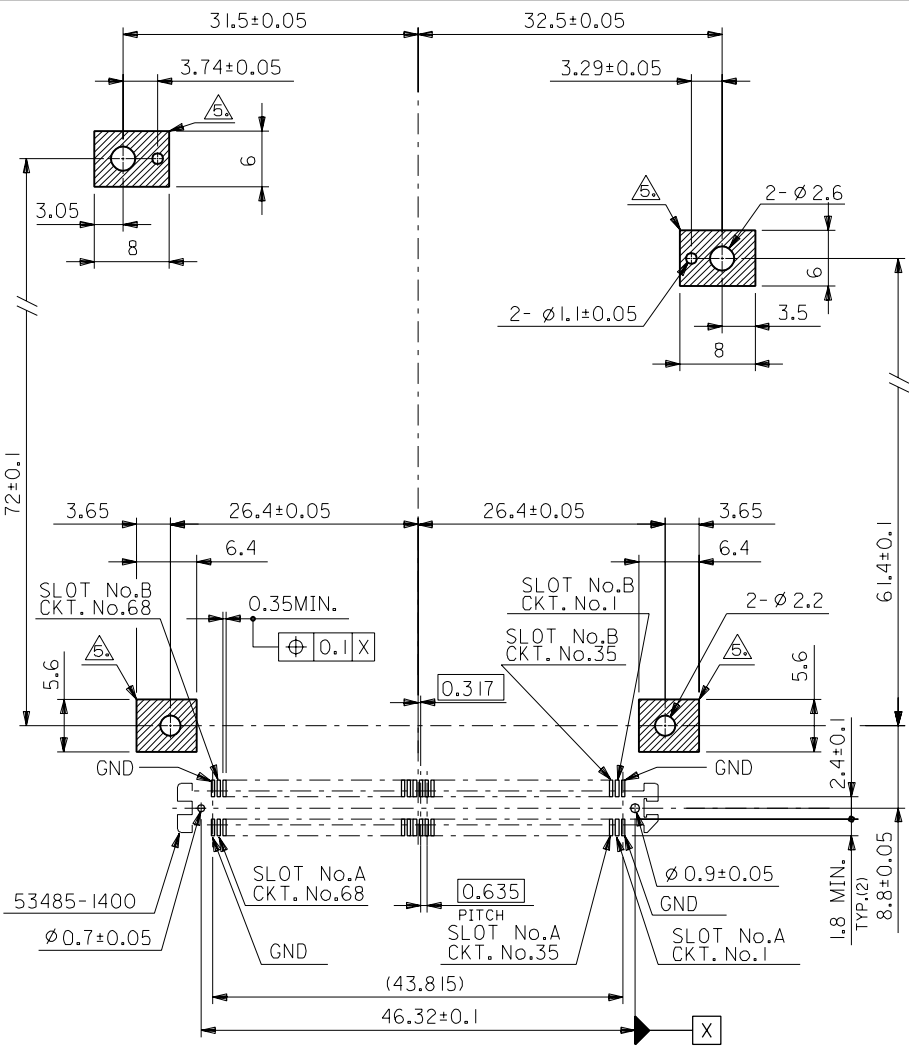
E

D

C

B

A



推奨基板寸法  
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT

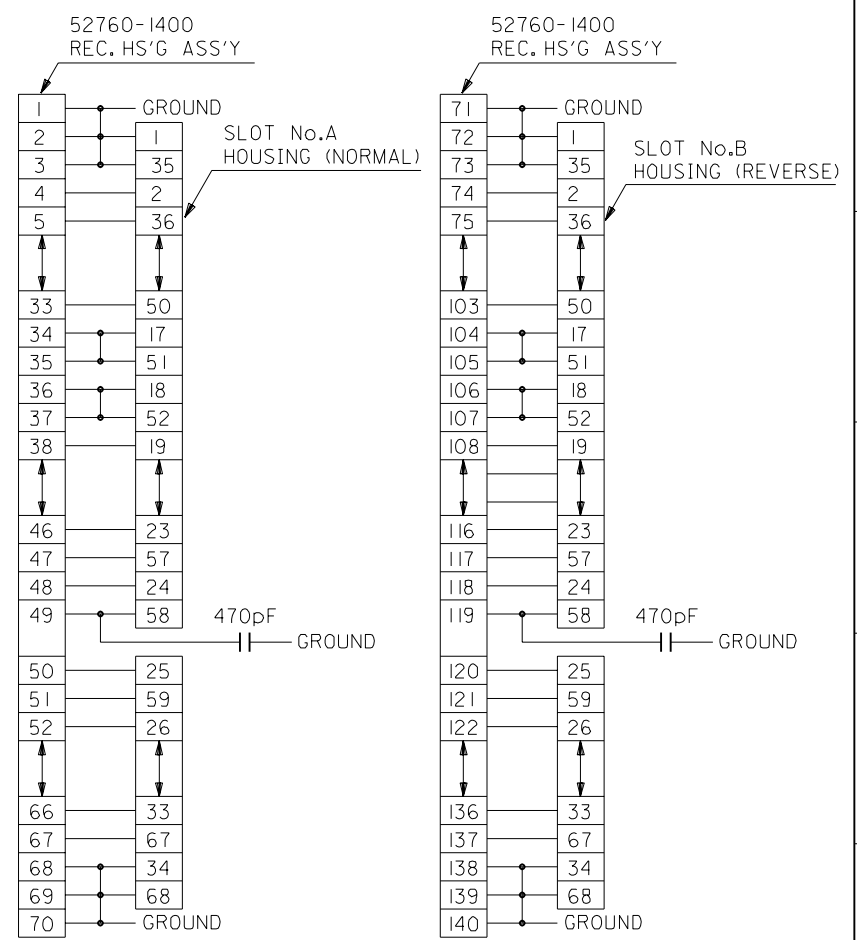


DIAGRAM A:  
CIRCUIT ASSIGNMENT DWG.

材料 MATERIAL		SHEET 3 OF 3 参照 SEE SHEET 3 OF 3		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		SHEET 3 OF 3 参照 SEE SHEET 3 OF 3		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—		MEMORY CARD CONN. EJECT MECHANISM METAL SHELL TYPE	
DRAWN BY		CHK'D BY		DWG. NO.	
A		H. Wata		SHEET 2 OF 3 REV	
DR. DATE		APP'D BY		SCALE	
0		H. Wata		2 - 1	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		SD-53524-1364	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		DR. DATE		B	
角度 ANGLE		99/01/13		D14:1100061553524526.DGN	
30°以上 OVER		B			
10°以上 30°未満 UNDER		A			
未過 10° UNDER		O			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。  
EN-OIC(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

DWG. NO. SD-53524-1364

E

D

C  
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

注)

NOTES  
 △ ボタンストロークが 6.5mmの時、カード飛び出し量は (3.2mm)。  
 ボタンストロークが 8.5mmの時、カード飛び出し量は (7mm)。  
 WHEN BUTTON PUSH STROKE IS 6.5mm, CARD OUT BY (3.2mm).  
 WHEN BUTTON PUSH STROKE IS 8.5mm, CARD OUT BY (7mm).

△ 接点部 CONTACT AREA 金めっき : 0.1 μmMIN.  
 Au PLATING : 0.1 μmMIN.  
 パラジウムニッケルめっき, Pd/Ni=80/20(%) 0.5 μmMIN.  
 Pd-Ni PLATING, Pd/Ni=80:20(%) 0.5 μmMIN.

半田付(テ部) SOLDER TAIL AREA 半田めっき, Sn/Pb=90/10(%) 2.0 μmMIN.  
 Sn-Pb PLATING, Sn/Pb=90/10(%) 2.0 μmMIN.  
 下地めっき UNDERPLATING ニッケルめっき : 1.5 μmMIN.  
 Ni PLATING : 1.5 μmMIN.

△ ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ 0.1 MAX.とする。  
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1  
 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.

△ ピン根元に適用する。  
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.

△ 部品実装禁止範囲。  
 NO PART TO BE MOUNTED IN THESE AREAS.  
 △ 半田めっき, Sn/Pb=90/10(%) 3.0 μmMIN.  
 Sn-Pb PLATING, Sn/Pb=90/10(%) 3.0 μmMIN.  
 銅下地めっき : 1.0 μmMIN.  
 Cu UNDER PLATING : 1.0 μmMIN.

No.	品名 NAME	材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	個数 PIECE
1	HOUSING (NORMAL)	ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0 LCP G.F. UL94V-0 色 : 自然色 COLOR : NATURAL	—	1
2	HOUSING (REVERSE)	ガラス入り耐熱樹脂 UL94V-0 LCP G.F. UL94V-0 色 : 自然色 COLOR : NATURAL	—	1
3	PIN	りん青銅 PHOSPHOR BRONZE	NOTES △ 参照 SEE NOTES △	136
4	METAL SHELL (FOR LEFT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.254 STAINLESS STEEL t 0.254	—	1
5	METAL SHELL (FOR RIGHT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.254 STAINLESS STEEL t 0.254	—	1
6	BUTTON	ガラス入りポリエステル UL94V-0 PBT G.F. UL94V-0 色 : 青色 COLOR : BLUE	—	2
7	PUSH ROD (FOR LEFT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.8 STAINLESS STEEL t 0.8	—	1
8	PUSH ROD (FOR RIGHT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.8 STAINLESS STEEL t 0.8	—	1
9	LEVER (FOR LEFT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.4 STAINLESS STEEL t 0.4	—	1
10	LEVER (FOR RIGHT SIDE BUTTON)	ステンレス鋼 t 0.4 STAINLESS STEEL t 0.4	—	1
11	FRONT BRACKET	ステンレス鋼 t 0.4 STAINLESS STEEL t 0.4	—	2
12	REAR BRACKET	冷間圧延鋼板 (SPCC) t 0.5 COLD ROLLED CARBON STEEL SHEETS t 0.5	NOTES △ 参照 SEE NOTES △	2
13	PCB	ガラス布基材エポキシ樹脂 t 0.8 GLASS FABRIC BASE, EPOXY RESIN t 0.8	—	1
14	0.635 PITCH B-T0-B S/T REC. HS'G ASS'Y	SD-52760-***0 参照 SEE SD-52760-***0	—	1
15	INSULATION SHEET	ポリエステル t 50μm POLYESTER t 50μm	—	1
16	FIXED CAPACITORS	470pF SIZE: L6X0.8	—	2

F

E

D

C

B

A

材料 MATERIAL		表参照 SEE CHART		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		表参照 SEE CHART		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称 MEMORY CARD CONN. EJECT MECHANISM METAL SHELL TYPE	
被覆外径 INS. RANGE		—		DWG. NO. SHEET 3 OF 3   REV	
DRAWN BY A. Urita	CHK'D BY Y. Saito	DATE 99/10/21	SCALE NONE	SD-53524-1364 B	
角度 ANGLE	+3°				
30 以上 OVER	+0.3	B	T.H.M.S.	99/10/13	
10 以上 30 未満 UNDER	+0.25	A	T.H.M.S.	99/11/18	
10 未満 UNDER	+0.2	O	T.H.M.S.	99/10/21	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE	APP'D BY (Signature)

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。  
 EN-01C(032)MXJ-32

D14:11000615535241364.DGN

8

7

6

5

4

3

2

1